



MeL専門別カタログ

# 【半導体微細加工技術】

半導体製造・加工の最新微細加工技術を紹介


電子書籍なら実験の待ち時間にタブレットで閲覧いただけます!!





書名	著編者	出版社	発行年	ISBN/ISSN	同時 1アクセス	同時 3アクセス
半導体の高次元化技術 —貫通電極による3D/2.5D/2.1D実装—	傳田 精一	東京電機大学出版局	2015	9784501330903	4,700	7,000
マイクロ・ナノデバイスのエッチング技術 (新材料・新素材シリーズ)	式田 光宏	シーエムシー出版	2009	9784781301679	11,000	16,500
半導体微細パターニング —限界を超えるポスト光リソグラフィ技術—	岡崎 信次	エヌ・ティー・エス	2017	9784860434670	88,000	132,000
レーザー微細加工 —基礎現象と産業応用—	新井 武二	丸善出版	2018	9784621302361	16,500	24,800

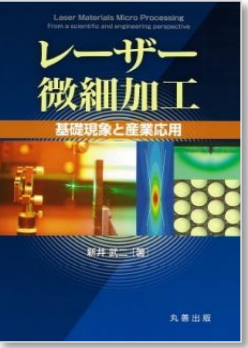
● 表示価格は税抜きです。

2018年7月

	<b>半導体の高次元化技術 貫通電極による3D/2.5D/2.1D実装</b>		分野		電気工学	
			同時1アクセス(本体)		¥4,700	
			同時3アクセス(本体)		¥7,000	
	著編者名	傳田 精一	冊子体ISBN	9784501330903		
	出版社	東京電機大学出版局	刊行年	2015年	商品コード	1022470252
<p>半導体を高次元化する技術の概要・特徴を紹介し、今後の技術動向と業界の展望について分かりやすく解説する。新しい技術として注目されているガラス基板についても取り上げる。</p> <p style="text-align: center;"><b>集積化のご参考に</b></p>						

	<b>マイクロ・ナノデバイスのエッチング技術 (新材料・新素材シリーズ)</b>		分野		電気工学	
			同時1アクセス(本体)		¥11,000	
			同時3アクセス(本体)		¥16,500	
	著編者名	式田 光宏	冊子体ISBN	9784781301679		
	出版社	シーエムシー出版	刊行年	2009年	商品コード	1023891585
<p>マイクロナノ領域でのモノづくりで、その中心的な役目を担っている「エッチング技術」に焦点を絞り、その基礎から応用までを網羅的に解説。半導体以外の材料や、エッチング技術の高機能化の実例にも触れる。</p>						

	<b>半導体微細パターニング 限界を超えるポスト光リソグラフィ技術</b>		分野		電気工学	
			同時1アクセス(本体)		¥88,000	
			同時3アクセス(本体)		¥132,000	
	著編者名	岡崎 信次	冊子体ISBN	9784860434670		
	出版社	エヌ・ティー・エス	刊行年	2017年	商品コード	1024896507
<p>光リソグラフィ技術を超えるポスト光リソグラフィ技術の開発動向を概観してポストムーアに向けた最新技術動向を追う！</p>						

	<b>レーザー微細加工 基礎現象と産業応用</b>		分野		電気工学	
			同時1アクセス(本体)		¥16,500	
			同時3アクセス(本体)		¥24,800	
	著編者名	新井 武二	冊子体ISBN	9784621302361		
	出版社	丸善出版	刊行年	2018年	商品コード	1027296239
<p>近年、製品の軽薄短小の模索は指摘素材の選定から微細な工法にまで及び、無接触工法のレーザー加工が大注目されている。本書では、ナノ秒、ピコ秒、フェムト秒などの短パルスレーザーによるレーザー微細加工の優位性を、様々な応用加工実験の蓄積にもとづく正確なシミュレーションによってレーザー微細加工の理論を体系化。レーザー加工技術研究の第一人者による待望された書。</p>						

● 表示価格は税抜きです。

2018年7月